

## Product Overview

## SK-AM62-SIP 设计包文件夹和文件列表



表 1 列出了 SK-AM62-SIP 中包含的文件夹名称、文件夹中的文件名称以及所有文件的格式。SK-AM62-SIP 入门套件 (SK) 评估模块 (EVM) 是一个独立的测试和开发平台，该平台基于 AM6254 片上系统 (SoC) 构建，在单个封装中集成了 512MB LPDDR4 SDRAM。AM625SIP 处理器由一个四核 64 位 Arm®-Cortex®-A53 微处理器和单核 Arm Cortex-M4F MCU 组成。产品概述文档位于 TI.com 上的 SK-AM62-SIP 产品文件夹中，供客户在下载单个 Zip 文件夹之前查看。

表 1. PROC162E1

文件夹 (第 1 级)	文件夹 (第 2 级)	所含文件	文件类型
----	----	PROC162E1_Folders_Files_List	XLS
		2024 年重要声明	PDF
1_SCHEMATIC	PDF	PROC162E1_Sch_With_Design_Updates..Notes_V1.0	
	PDF -Backup_SK_Schematic	PROC162E1_sch	PDF
	----	Proc162E1_Schematic_Revision_Readme	PDF
	ORCAD	PROC162E1_Sch_With_Design_Updates..Notes_V1.0	DSN
	ORCAD - Backup_SK_Schematic	PROC162E1_SCH	DSN
2_BOM	----	PROC162E1_BOM_With_Design_Updates..Notes_V1.0	XLS
	Backup_SK_Schematic_BOM	PROC162E1_BOM	XLS
3_Board_File	Allegro	PROC162E1_BRD	BRD
	Simulation Scorecard	AM62x_Simulation_Scorecard	PDF
	Altium_ASCII	PROC162E1_BRD	ALG
4_Gerber	ODBGBR	PROC162E1_ODBGBR	ZIP
	274X	PROC162E1_274xGBR	ZIP
	IPC-D-356_NETLIST	PROC162E1_BRD	IPC
5_Gerber_PDF	FAB	PROC162E1_FAB	PDF
	PCB LAYERS	PROC162E1-LAYERS	PDF
	Geber Layers	PROC162E1-LAYERS	PDF
6_Assembly_Models_Packag e	2D	PROC162E1_BASY	DXF
		PROC162E1_TASY	DXF
	3D	PROC162E1_3D_STEP	STP
		IDF	PROC162E1_BRD
	PROC162E1_BRD		EMN
	Assembly_Drawing_PDF	PROC162E1_ASSEMBLY	PDF
		PROC162E1_TASY	PDF
		PROC162E1_BASY	PDF
STNL	art_aper + 8 x .ART 文件	ART	
XY-REP	PROC162E1_XY-REP	XLS	
7_PCB_LAYER_STACKUP	---	SK-AM62-SIP_PROC162E1_Layer_STACKUP	PDF

## 参考资料

- 德州仪器 (TI), [\[常见问题解答\] AM625SIP - 定制电路板硬件设计 - 关于重复使用 SK-AM62-SIP 原理图的设计和审阅说明](#) 文章

## 重要声明和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、某特定用途方面的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他功能安全、信息安全、监管或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的应用。严禁对这些资源进行其他复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。您应全额赔偿因在这些资源的使用中对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 的销售条款](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款/TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

邮寄地址：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265  
Copyright © 2024，德州仪器 (TI) 公司